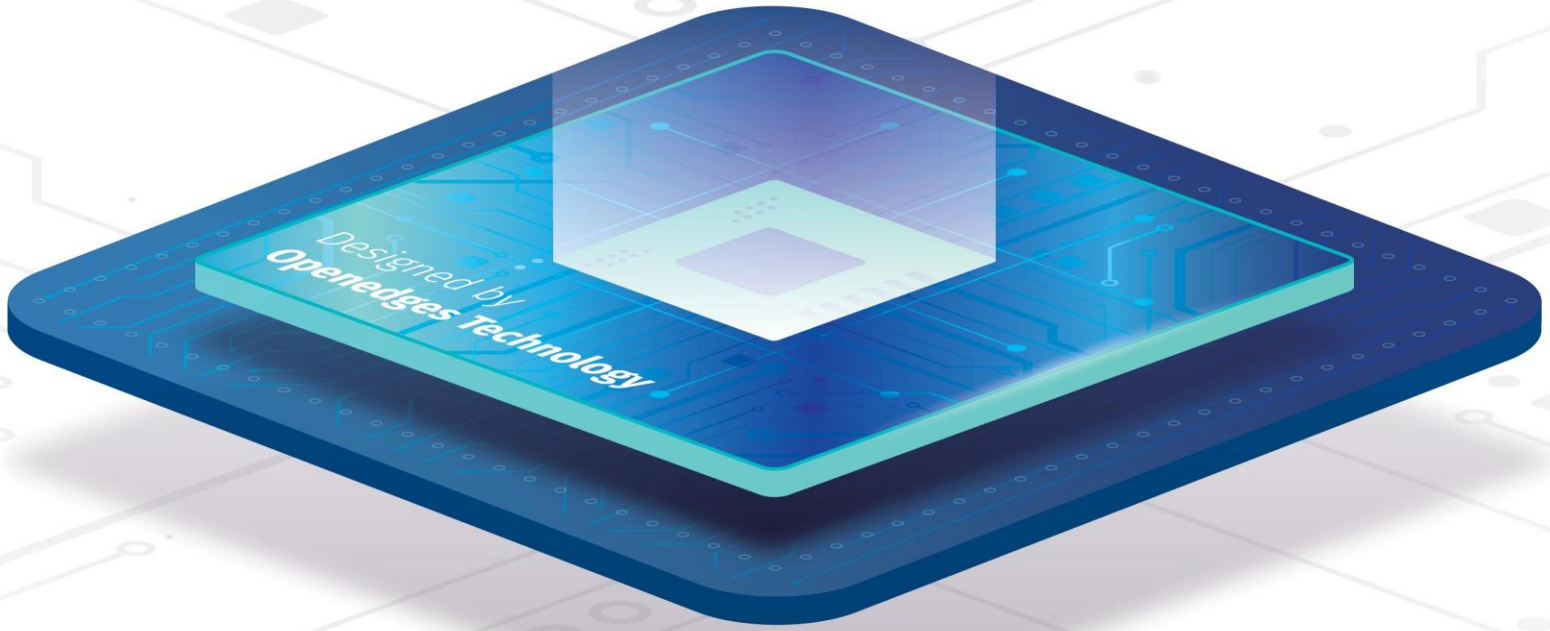
AI for Everyone, Everywhere



OPENEDGES

INVESTOR RELATIONS 2025 ©2025 OPENEDGES

Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서 정보 제공을 목적으로 오픈엣지테크놀로지 주식회사 (이하 "회사")에 의해 작성됐으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)'등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 경영 환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장 환경과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대해 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 하지 않으며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

OPENEDGES

The Future of AI Computing

Table of Contents

Openedges Technology At a Glance

Prologue

01 시스템 반도체 시장의 구조적 성장

02 국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업, 오픈엣지테크놀로지

03 FY2024 경영실적

04 중장기 성장전략

Appendix

Openedges Technology at a Glance

94%
연매출 성장률(최근 5년)
* '20년~'24년

66
누적 라이선스 계약
* '25년 3월말 기준

173
Global R&D Engineers
* 전체 인력(193명)중 90%
(한국 최대규모)

AI for Everyone, Everywhere

OPENEDGES

30+
고객사 수
* 삼성전자, SK Hynix, Micron 등
글로벌 Top-tier 고객 기 확보

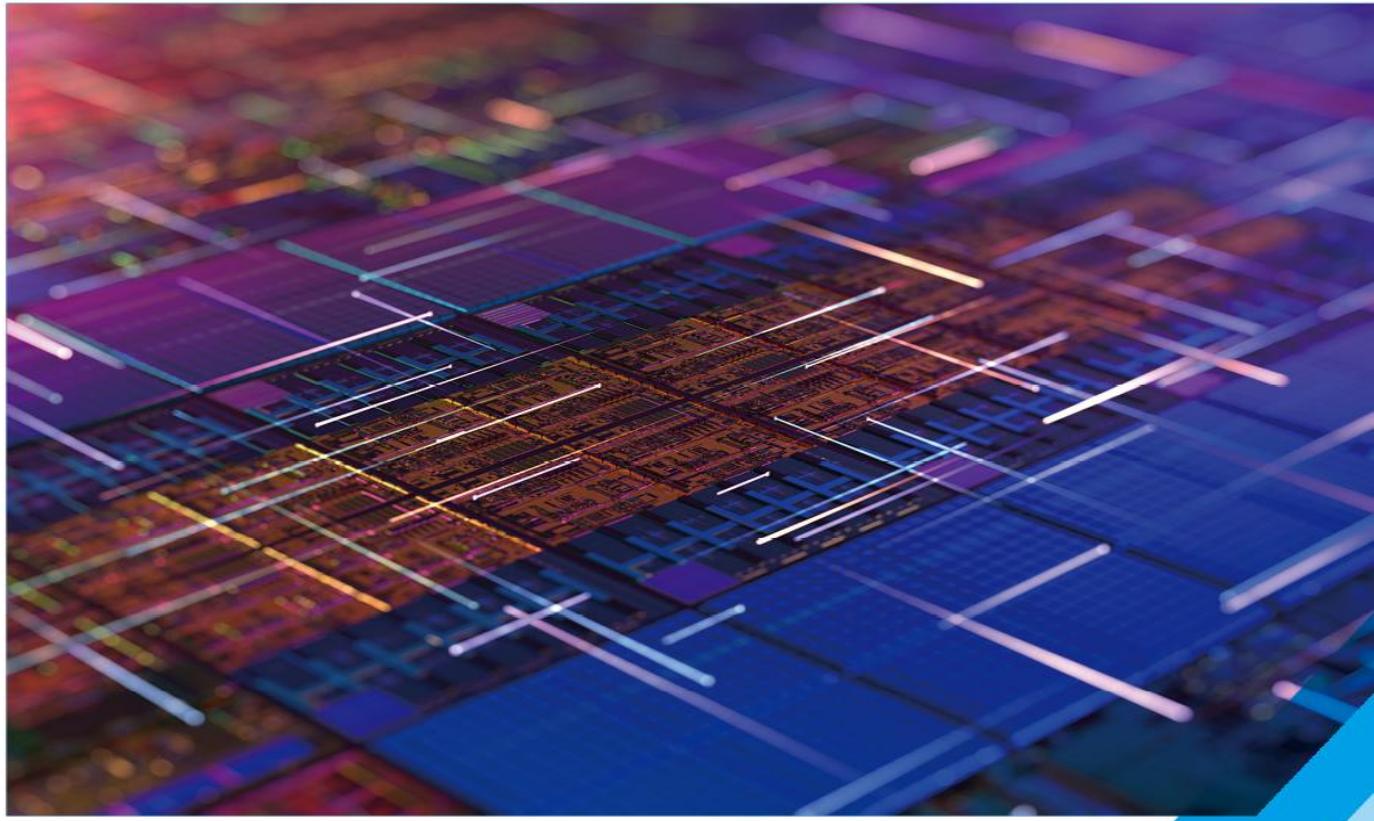
20+
판매가능 IP 제품 수
* IP 종류는 총 4종이며
각 제품군 내 판매가능 개별 IP 제품 수

4
글로벌 R&D 센터
* 한국, 미국, 캐나다, 일본 소재

AI for Everyone, Everywhere

Prologue

오픈엣지테크놀로지 사업 영역

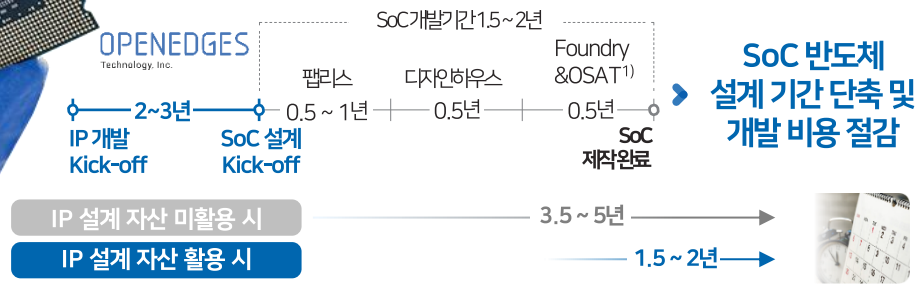


오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ①

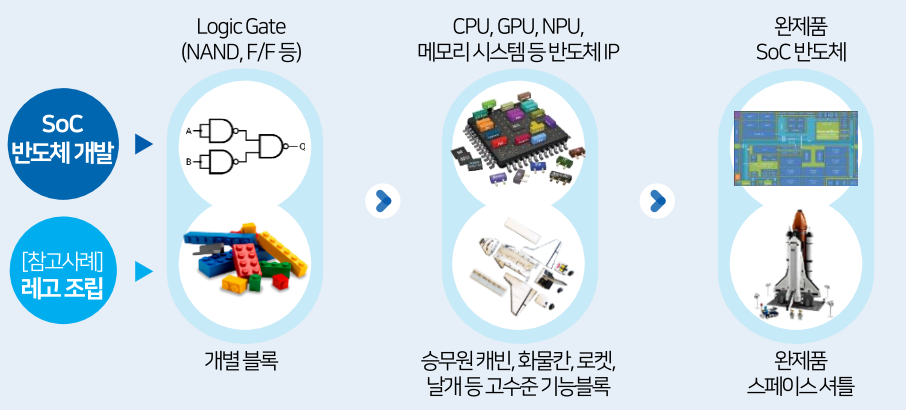
반도체 IP는 AI 반도체를 포함한 SoC (System on Chip)의 개발 기간 단축과 비용 절감 및 천억 원 이상 규모의 개발 실패의 위험을 경감시키는 높은 수준의 기술력이 요구되는 Ready-made 솔루션

반도체 IP란?

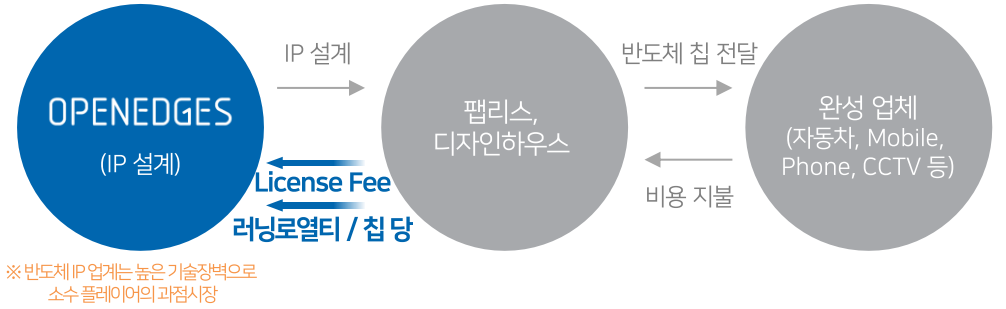
CPU, GPU, NPU 등 SoC에 들어가는
사전적으로 설계/검증된 기능 블록



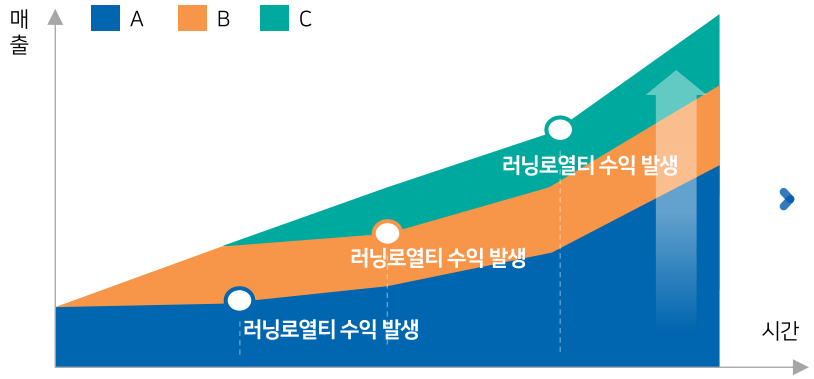
참고 사례



반도체 IP 사업의 수익 구조



※반도체 IP 업계는 높은 기술장벽으로 소수 플레이어의 과점시장



License Fee와 러닝 로열티가 결합된 수익 구조

*주1) Outsourced Semiconductor Assembly and Test (패키징 등 후공정 업체)

오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ②

AI 반도체의 구동 기반이 되는 통합 IP 솔루션 설계 및 제공

AI반도체

인공지능 학습과 실행에
최적화된 신경망 처리장치

① NPU

스케줄링 알고리즘에 따라 SoC와 DRAM 간
고속 데이터 통신을 제어

③ Memory Controller

④ PHY

SoC와 DRAM 간
고속 데이터 전송

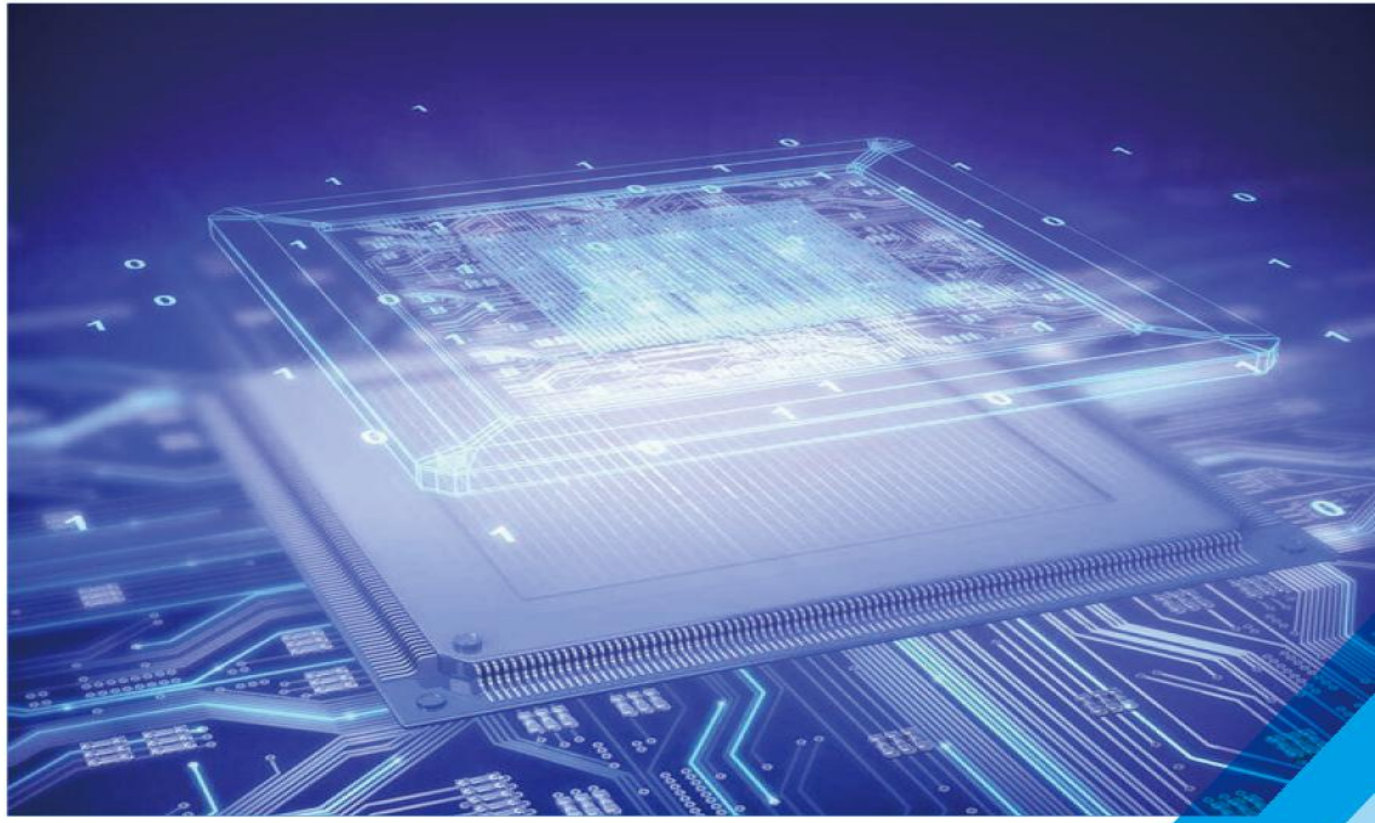
② On Chip Interconnect

SoC 內 데이터 이동 통로

01

시스템 반도체 시장의 구조적 성장

01. AI반도체 및 IP 시장 성장
02. 반도체 IP 설계업체의 역할



01 | AI 반도체 및 IP 시장 성장

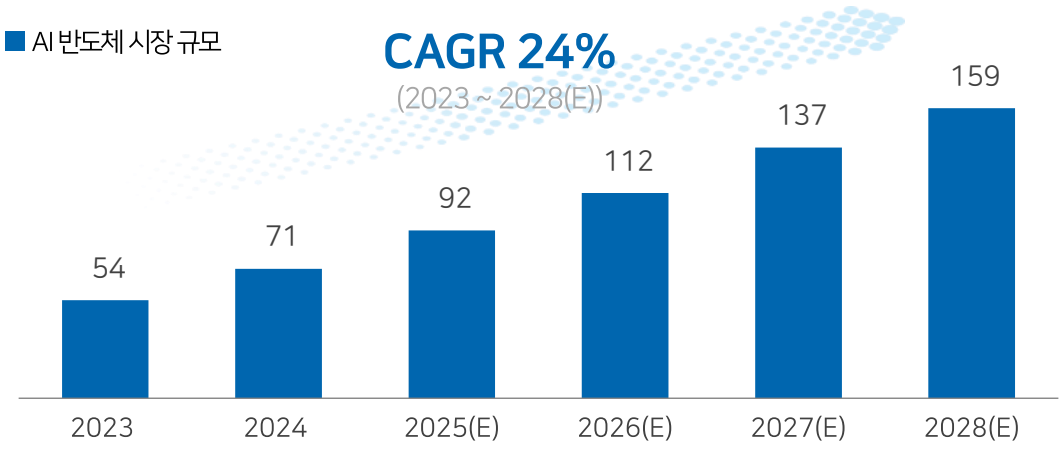
AI반도체와 IP시장의 견조한 성장세 지속

2025년 글로벌 반도체 시장 전망

※ Source: Semiconductor Market Outlook (IDC, Oct. 2024)

글로벌 AI 반도체 시장 전망

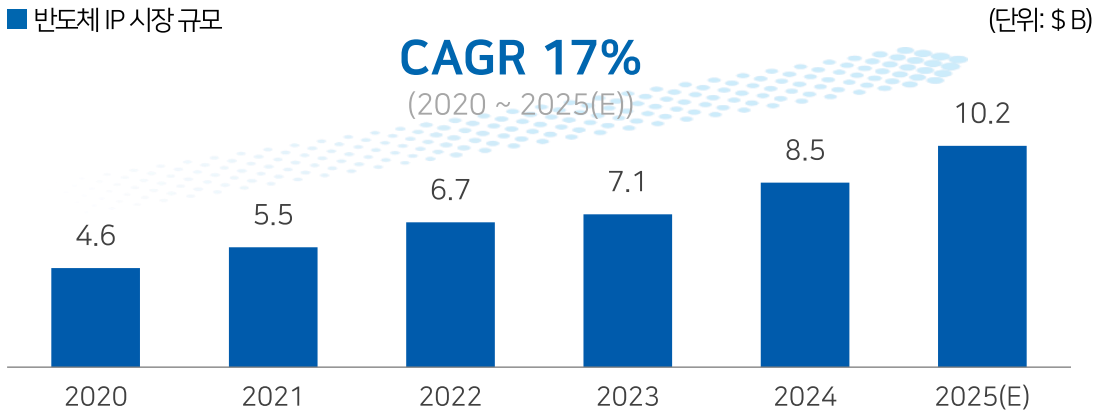
(단위: $ B)



※ Source: AI Semiconductor (Gartner, May 2024), 당사 추정

반도체 IP 시장 전망 및 경쟁 현황

업체명	2024 매출 ($ M)	CAGR ('20 ~ '24)
arm	3,694	13%
SYNOPSYS	1,906	17%
cadence	498	12%
OPENEDGES	11	94%
Others		10%
Total		**13%**



※ Source: Design IP revenues (Ipnest, Apr 2024), Press Clipping

02 | 반도체 IP 설계 업체 역할

반도체 IP 기업은 팹리스 및 디자인하우스가 필요로 하는 기능 블록을 선제적 개발 및 공급

시스템반도체 Ecosystem

	반도체 IP 설계 업체	팹리스 (Fabless)	디자인 하우스	파운드리 (Foundry)	(O)SAT[1]
주요 업무	반도체 주요 기능블록 설계	반도체 칩 설계 (Frontend 설계 담당)	반도체 칩 설계 외주 (Backend 설계 담당)	반도체 칩 제조 (Wafer 공정 업체)	후공정 담당 (패키징 업무)
Player 수	50개 내외 기업 과점 시장	3,500개 이상	약 80개	약 20개 (Top 10 M/S 97% 차지)	100개 내외 (Top 25 M/S 50% 차지)
시장규모	$8.5B *기업당 시장 파이 최대규모	$198B	$8.0B	$125B	$63B
주요 업체	OPENEDGES, arm, SYNOPSYS, cadence	Qualcomm, NVIDIA, BROADCOM, MEDIATEK, AMD	GUC, GAONCHIPS, asicland, ADTechnology, SEMI FIVE	tsmc, SAMSUNG, GLOBAL FOUNDRIES, UMC	ASE GROUP, Amkor Technology, JCET, SPIL

IP시장의 과점화 이유

검증된 IP에 대한 니즈 증가

진입장벽이 높아 검증된 IP 업체의 희소 가치 부각

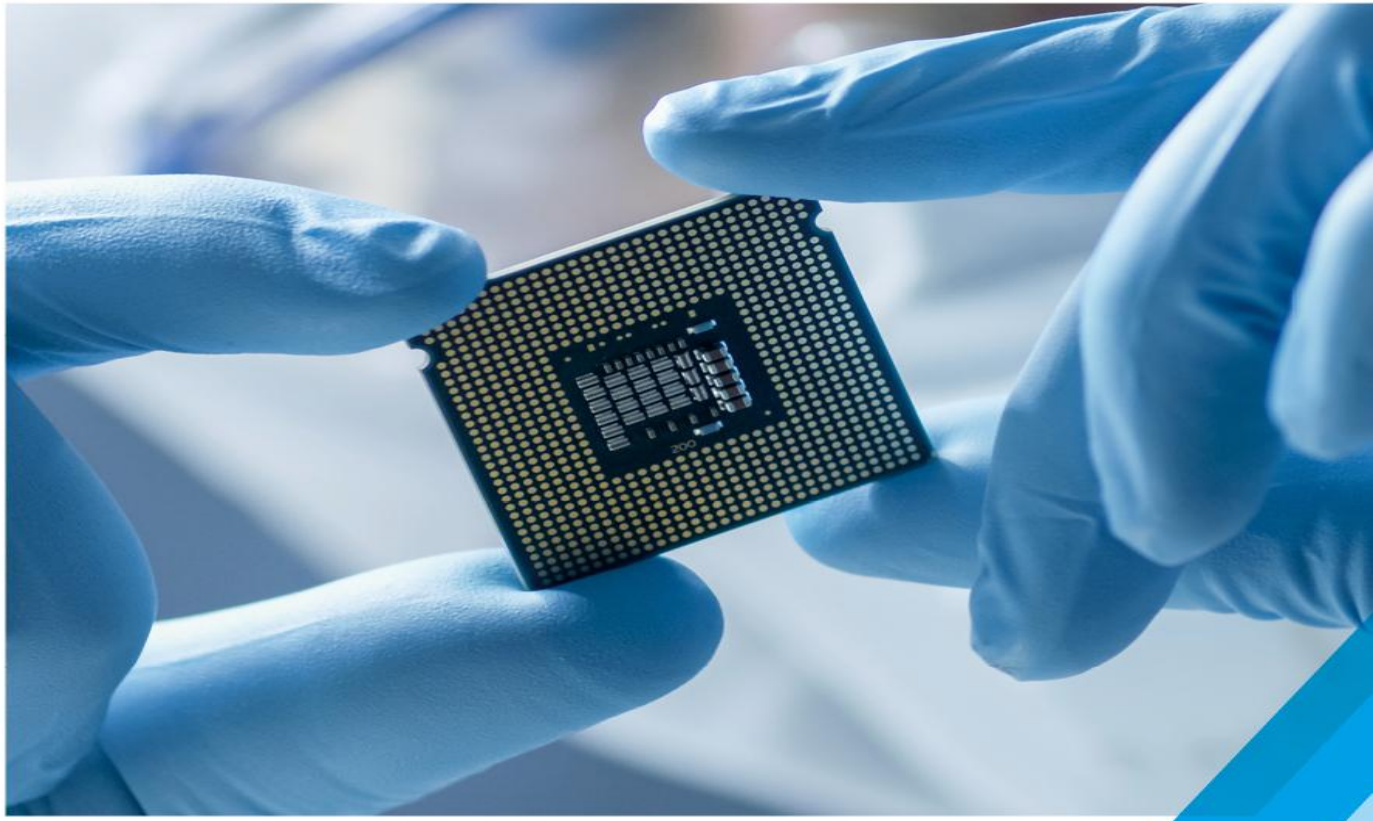
- 고도의 기술 인력 필요
- 최소 3년 이상의 R&D 투자 필요

*주1) Outsourced Semiconductor Assembly and Test: 반도체 패키지 조립 및 테스트 업체로 웨이퍼 공정 이후 후공정 담당

02

국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업, 오픈엣지테크놀로지

01. 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary
02. 글로벌 최고 수준의 Manpower
03. 업계 최고 수준의 기술경쟁력
04. 검증된 글로벌 Track Record
05. 글로벌 기업과의 전략적 Partnership



01 | 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary

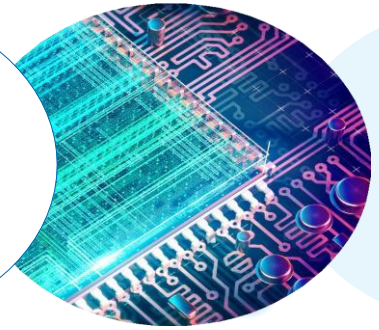
오픈엣지는 AI 반도체 IP 시장의 글로벌 리더가 되기 위한 핵심 성공요인을 확보

01

글로벌 최고수준의
Manpower

02

업계 최고수준의
기술경쟁력



03

검증된
글로벌 Track Record

04

글로벌 기업과의
전략적 Partnership

02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower - Global Presence

한국 외 미국, 캐나다, 일본 소재 글로벌 R&D 거점 확대

OPENEDGES

주요 역할	IP R&D 및 Sales
설립 시기	'17년 12월
임직원수	총 111명*

50%

Openedges Square

주요 역할	Online IP Sales Platform
설립 시기	'23년 8월
임직원수	총 19명*

100%

Openedges Technology Corporation

주요 역할	북미 지역 영업 거점
설립 시기	'21년 7월
임직원수	총 2명*

100%

The Six Semiconductor

주요 역할	DDR PHY IP R&D
설립 시기	'18년 6월('19년 12월 M&A)
임직원수	총 38명*

100%

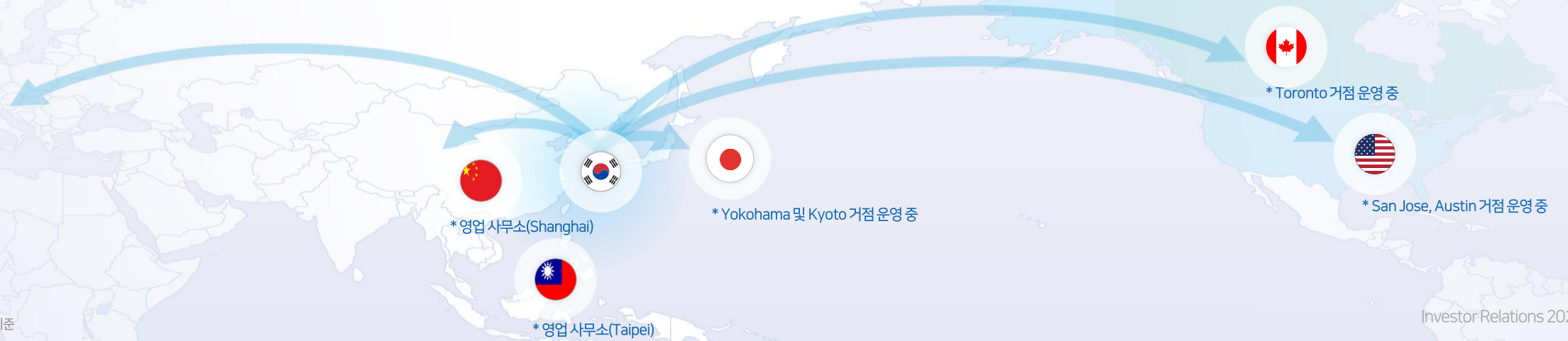
Openedges Square Corporation

주요 역할	Cache Coherence NOC IP R&D
설립 시기	'23년 8월
임직원수	총 19명*

100%

Openedges Technology Japan

주요 역할	Memory Controller IP R&D
설립 시기	'24년 3월
임직원수	총 4명*



* '25년 3월말 기준

02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower

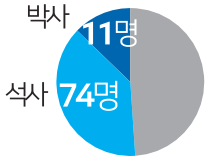
국내 최대 규모 및 Global 경쟁력을 갖춘 R&D Engineer들이 확보된 반도체 IP 설계기업

전사 R&D 인력현황

총 인원(193명)의
90%

173명
R&D인력

R&D 인력 중
석박사(85명) 비중
49%



지역별 현황

한국 **130명**
캐나다 **38명**
미국 **21명**
일본 **4명**

* '25년 3월말 기준

이성현
대표이사 / CEO

SAMSUNG | SAMSUNG ADVANCED INSTITUTE OF TECHNOLOGY

서울대학교 전기·컴퓨터공학 박사 수료
'17~ 現 오픈엣지테크놀로지㈜ 대표이사
'08~'15 삼성전자 수석연구원 (Exynos 개발)
'07~'08 삼성종합기술원

최정환
NPU 팀장

SK hynix | SAMSUNG

Purdue대학교 전기 및 컴퓨터공학 박사
'18~ 現 오픈엣지테크놀로지㈜ NPU팀장
'15~'18 SK 하이닉스 수석연구원
'09~'14 삼성전자 Architecture Lab 파트장

Richard Fung
TSS / CEO

AMD | PERASO

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사
'18~ 現 The Six Semiconductor CEO
'12~'18 Peraso Technologies Silicon Director 등
'00~'11 AMD PHY Analog Design Manager

Roger Jennings
OSC / VP of Engineering

ARTERIS IP | AMD | intel

Univ. of Memphis 전자전기공학 석사
'22~ 現 오픈엣지스퀘어 미국법인 VP of Engineering
'20~'22 Arteris IP Senior Director of Engineering
'02~'20 Intel, Juniper Networks, AMD 등

황인조
CTO / Co-founder

Codeholics/codeholics | 대우전자 | Chips&Media

서울대학교 전기공학 석사
'17~ 現 오픈엣지테크놀로지㈜ CTO
'10~'15 코드홀릭스 CTO
'00~'10 대우전자, 칩스앤미디어

Takashi Yamada
OTJ/Reginal VP

socionext | Panasonic

University of Tokyo Denki, 전기공학 학사
'24~ 現 오픈엣지테크놀로지 일본법인 Regional VP
'15~'24 SOCIONEXT Inc., Principal Engineer
"88~'15 PANASONIC Corporation

Ricky Lau
TSS / CTO

AMD | SYNOPSYS

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사
'18~ 現 The Six Semiconductor CTO
'14~'18 Synopsys PHY Digital Design Engineer
'03~'14 AMD PHY Analog Design Engineer 등

Niranjan Cooray
OSC/Chief Architect

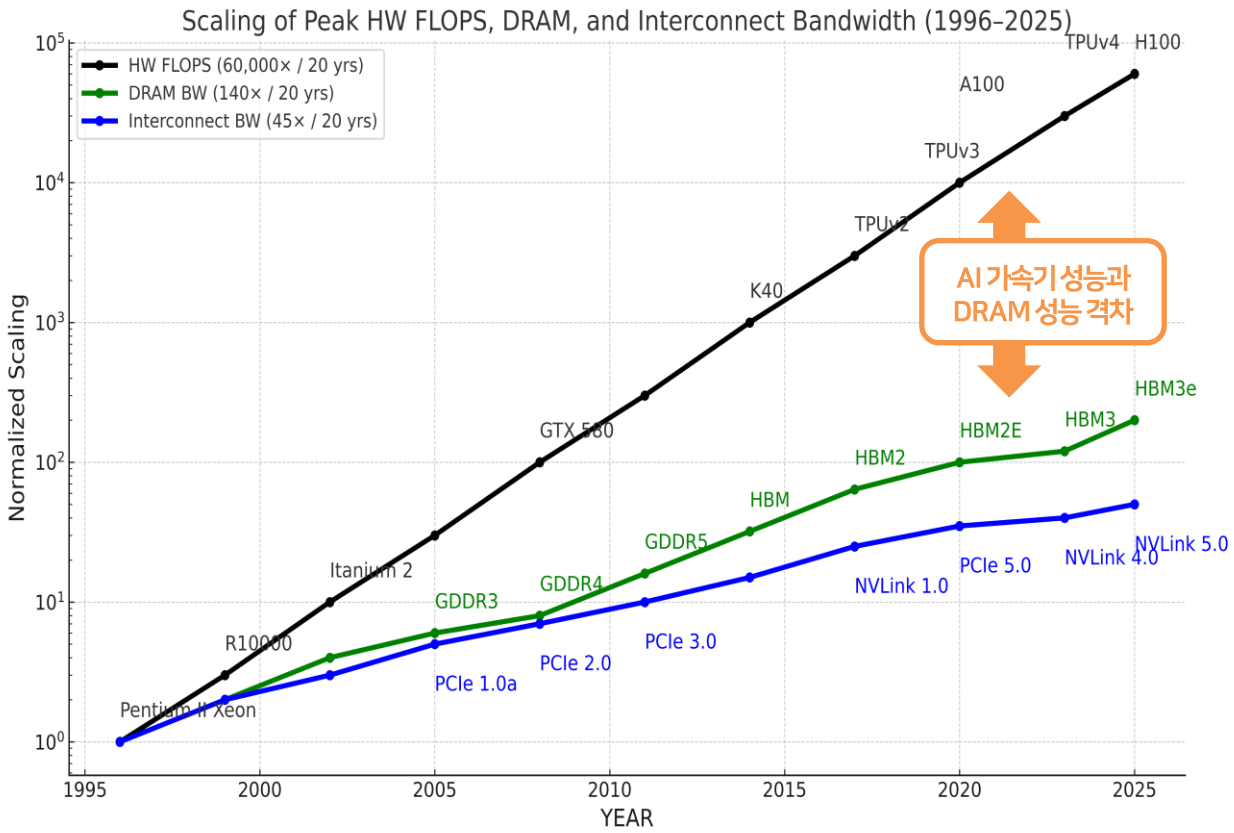
intel

Northeastern University, 전기 및 컴퓨터공학 석사
'24 ~ 現 오픈엣지스퀘어 미국법인, Chief Architect
'95 ~ '24 Intel, Principal Engineer

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ①

AI 반도체는 'Data Intensive Computing' → 자원이 제약된 엣지 환경 아래 NPU와 메모리 시스템 최적화가 필수
오픈엣지는 글로벌 유일 AI 반도체 통합 IP 솔루션 공급 가능 업체

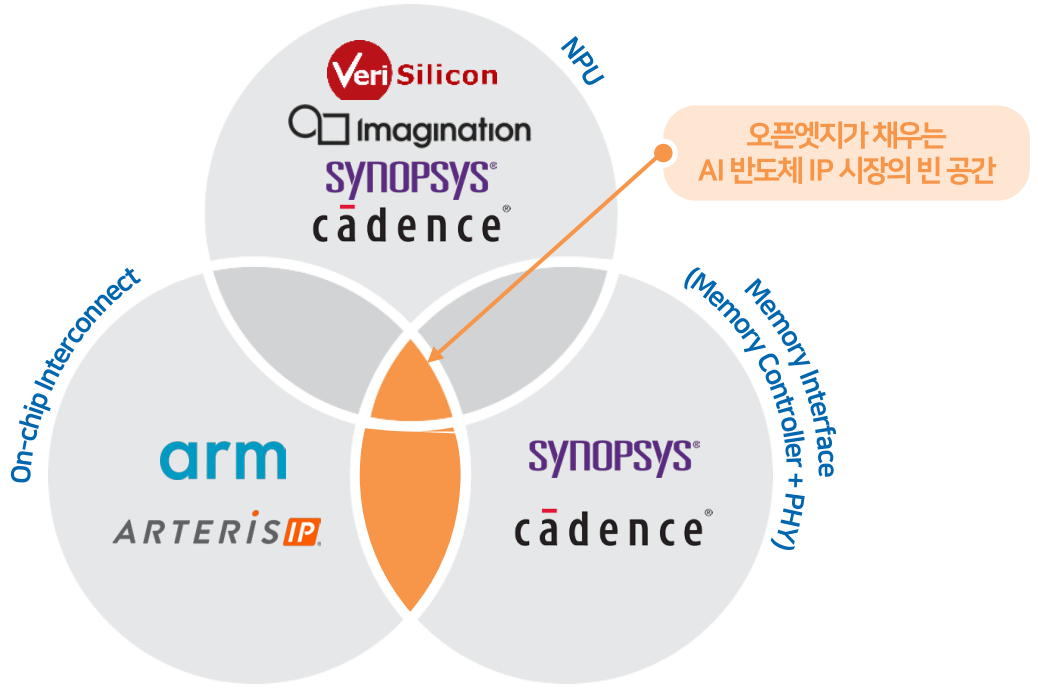
AI 가속기 기술 발전에 따라 Data 처리 요구량과 DRAM에서 제공하는 성능 간 격차 확대



※ 출처: AI And Memory Wall By Riselab, nvidia.com, JEDEC.org, PCISIG.com 등

AI Platform IP for Edge Computing

오픈엣지는 AI 반도체의 핵심인 NPU IP와 모든 반도체의 'Back Bone' 역할을 하는
메모리 시스템 IP 동시 공급이 가능한 글로벌 유일한 회사



03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ②

최선단 공정 중심 기술개발 중이며, 최근 On-Device용 칩 개발 수요에 효과적으로 대응하기 위해 LPDDR용 IP 개발 집중

구분	IP	Description	개발현황	Remark
AI Platform IP Solution for Edge Computing	ENLIGHT™ (Neural Processing Unit)	ENLIGHT™-v1.0 (0.25 ~ 2 TOPS)	Now	경량 IoT 응용제품(키워드 인식, 보안카메라 급 응용)
		ENLIGHT™-v2.0 (2 ~ 16 TOPS)	Now	중급 이상 IoT 응용제품(자율주행 보조 급 응용)
		ENLIGHT™-v2.1	**개발 중 (~'26년 1H)**	**Image Enhancement support**
		ENLIGHT™-v3.0 (16 ~ 250 TOPS)	Now	차량용 고성능 응용제품(레벨3급 이상 자율주행 차량 응용)
		ENLIGHT™-v3.1	**개발 중 (~'26년 1H)**	**Language Model (sLM 등)**
Total Memory System Solution IP (ORBIT™)	OMC™ (DDR Memory Controller)	DDR4/3, LPDDR4X/4/3	Now	
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	현재 Mainstream 기술
		HBM3	Now	서버 및 초고성능 제품 향
		DDR5	Now	현재 Mainstream 기술
		GDDR6	Now	고성능 AI 제품 향
		GDDR7	개발예정	차세대 고성능 AI 제품 향
		LPDDR6	**개발 중 (~'25년)**	**차세대 Mainstream 기술**
	OPHY™ (DDR PHY)	LPDDR4X/4	Now	TSMC 22nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4(up to 8.5Gbps)	Now	TSMC 6nm, 7nm, 12nm, 16nm 공정용
		GDDR6	Now	TSMC 12nm 공정용
		HBM3	Now	TSMC 6nm, 7nm 공정용
		LPDDR6	개발 예정	TSMC 4nm 이하 공정용
		LPDDR3, DDR4/3	Now	Samsung 28nm 공정용
		LPDDR5/4X/4	Now	Samsung 8nm, 14nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4(up to 8.5Gbps)	Now	Samsung 5nm 공정용
		LPDDR5 X (up to 10.7Gbps)	**개발 중 (~'25년)**	**Samsung 4nm 공정용**
		LPDDR6(up to 14.4Gbps)	개발 중 (~'25년)	Samsung 4nm 공정용
		GDDR7	개발 예정	
	OIC™ (On-Chip-Interconnect)	OIC™	Now	Non-Cache-Coherent NoC
		OIC™-AI	개발 중	Cache-Coherent NoC
Chiplet	D2D Chiplet Controller	UCIe v1.1	개발 중 (~'26년 1Q)	Full Spec.
	UCIe PHY	UCIe 2.0 PHY	개발 중 (~'26년)	TSMC 6/7nm 예정

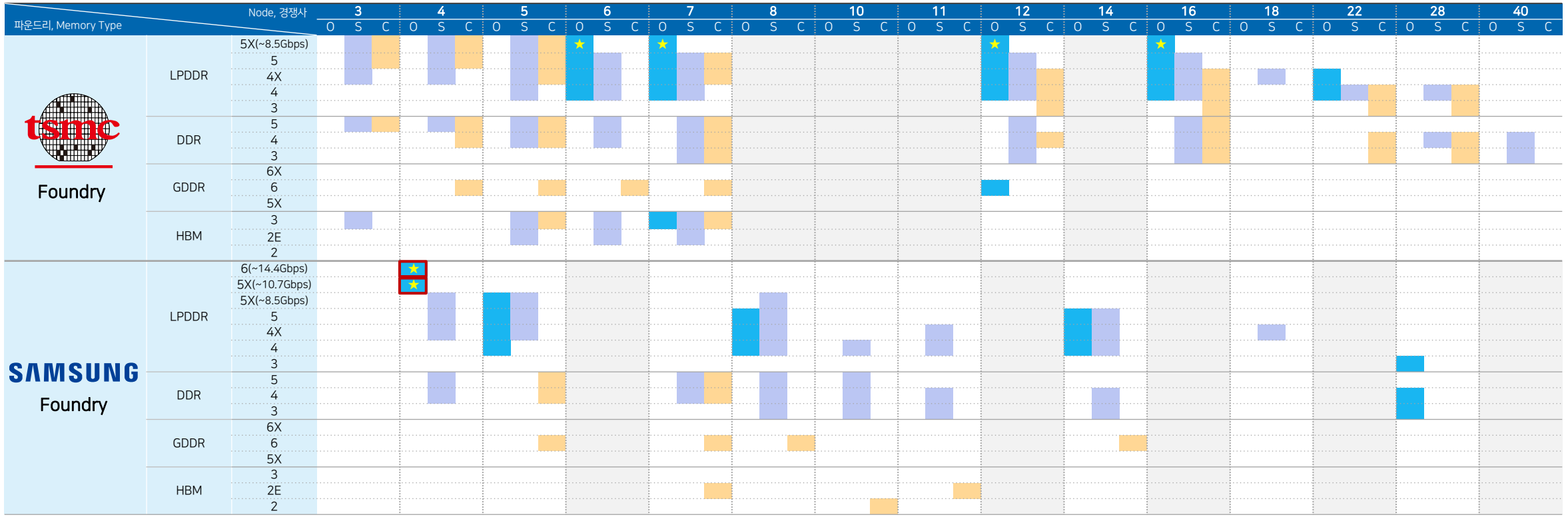
03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ③

글로벌 주요 경쟁사가 Cover하지 못하고, 고객사가 Affordable한 영역에 역량을 집중, 시장 점유율 확대

DDR PHY IP 경쟁 현황

개발예정 IP, ★: 당사만 제공 중인 IP

Openedges | Synopsys | Cadence



오픈엣지테크놀로지 시장 점유율 확대 전략

- Synopsys와 Cadence는 TSMC 5나노 이하 선단 공정에 집중
- 오픈엣지 테크놀로지는 다수의 공정에서 LPDDR5X/5 용 PHY IP를 단독으로 고객에게 제공하는 전략으로 제품차별화를 실현
- '25년까지 SF 4nm PHY IP 개발을 통해 선단 공정 관련된 IP강화 및 고객사 POOL 확대 기대 중
- 경쟁사 대비 50% 이하의 면적으로 구현한 test chip에서의 성능 확보를 통한 제품 경쟁력 제고

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ④

최선단 공정의 지속 개발을 통해, AI 반도체 통합 IP 솔루션의 선점 효과를 극대화할 예정

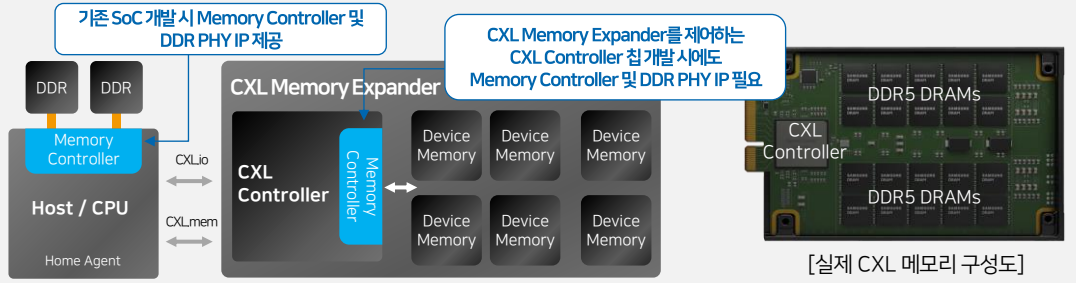
예상 출시 일정		2024	2025		2026		2027	
			1H	2H	1H	2H	1H	2H
OMC™ Memory Controller			LP6/5X Combo		DDR6/GDDR7/HBM4E(미정)			
OPHY™ DDR PHY	SAMSUNG		LP6/5X(4nm), LP5X(~10.7Gbps)/4X(4nm)		LP5X/4X(미정)		LP6X/5X(미정)	
			LP5X/4X/4(8nm)					
	tsmc				LP5X(~10.7Gbps)/4X(미정)		LP6/5X(미정)	
OIC™ On-Chip Interconnect	Non-Cache Coherent NOC		OIC v2.1	OIC v2.2		OIC v2.3		
	Cache Coherent NOC		CC v1.0			CC v1.1		
OUC (D2D Chiplet Controller)			UCIe v1.1(Full Spec.)		UCIe v2.0			
OPHY (UCIe PHY)	tsmc				UCIe 2.0 PHY(6/7nm)			
ENLIGHT™ Neural Processing Unit			NPU v2.1(Image Enhancement Support)					
			NPU v3.1(Language Model (sLM))					

03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ⑤

고부가가치 차세대 반도체 기술 분야에서 폭발적인 성장기회 모색

CXL (Compute eXpress Link)

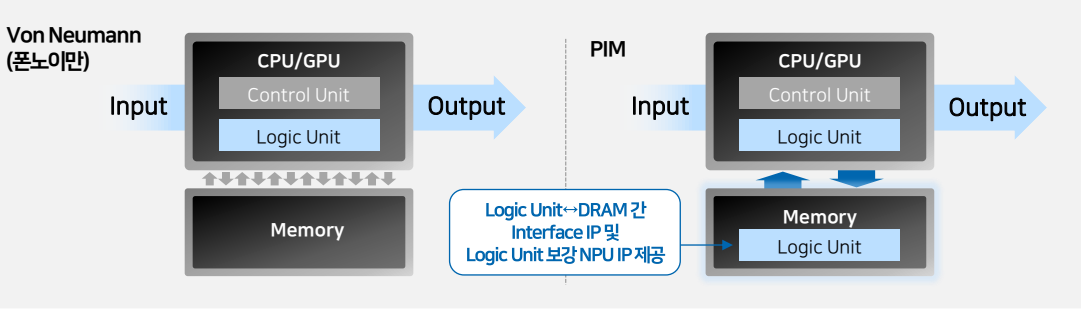
- CXL interface는 기존의 Host/CPU에 종속적인 메모리 표준 용량 및 성능에 대한 제한 없이, 유연하게 메모리를 확장 가능 → AI 반도체와 같은 Data Intensive 고성능 연산 효과적 지원
- 오픈엣지는 CXL Memory Expander의 핵심인 CXL Controller 칩 설계용 IP를 공급



[실제 CXL 메모리 구성도]

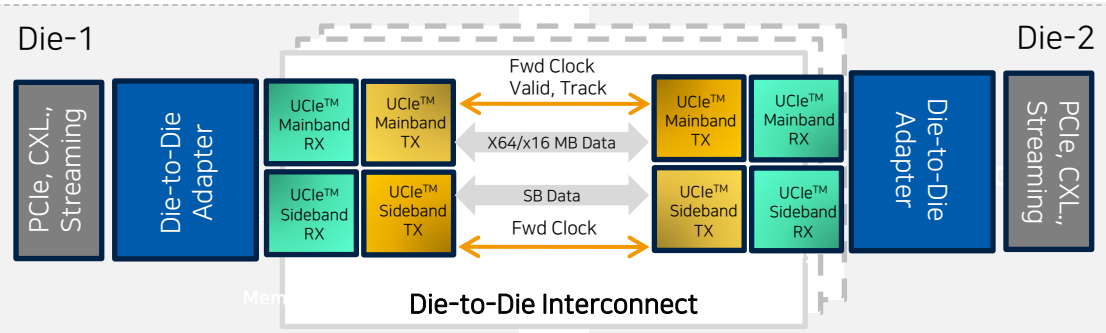
PIM (Process-in-Memory)

- PIM은 Host/CPU에서 담당(폰노이만 구조)하는 연산기능의 일부를 off-loading하여 PIM에서 처리 → 연산/저장기능 동시 수행으로 속도 ↑ + 전력소모 ↓
- 오픈엣지는 PIM 반도체 내 Logic Unit과 DRAM 간 Data Interface를 담당할 Memory System IP와, Logic Unit의 성능 향상에 필요한 NPU IP를 공급 가능



UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express)

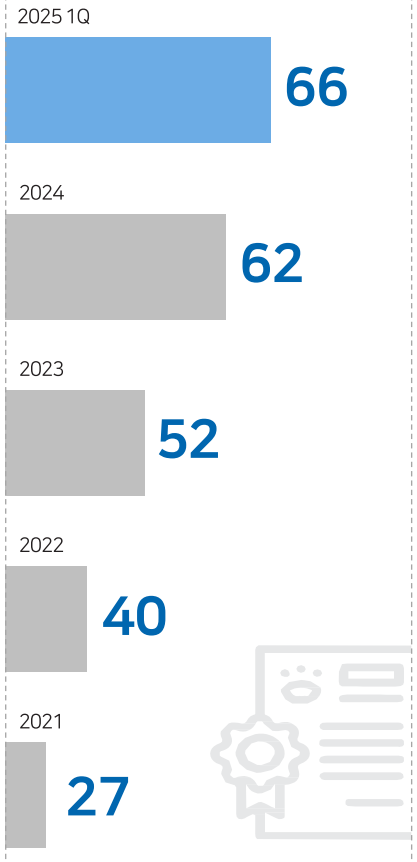
- UCIe는 서로 다른 칩렛들을 고속으로 연결하기 위한 통일된 인터페이스 표준
  미세화가 한계에 다다르면서 작은 칩 여러 개를 조합
  → 비용절감효과와 더불어 Chiplet간 호환성 확보
- 오픈엣지는 UCIe Controller를 이미 개발하여 보유 중이며 '26년까지 UCIe PHY도 개발예정
  → 기존 Memory System IP와 Integration을 통한 IP portfolio 확대 및 경쟁력 확보



04 | 검증된 글로벌 Track Record

다양한 산업의 필수 솔루션으로 가치를 인정받아 글로벌 Track Record 확대 중

연도별 라이선스 체결 누적 거래건수



05 | 글로벌 기업과의 전략적 Partnership

안정적 IP 수요 확보 + 최신 기술 및 시장 트렌드에 대한 선도적 대응

타 IP 기업과의 Partnership 강화

- 글로벌 A 社
- 글로벌 C 社
- 글로벌 M 社

→ 통합IP 제공을 위한 전략적Partnership 협의 중

Qualitas SEMICONDUCTOR, HANA MICRON

→ Chiplet 정부 과제 수행

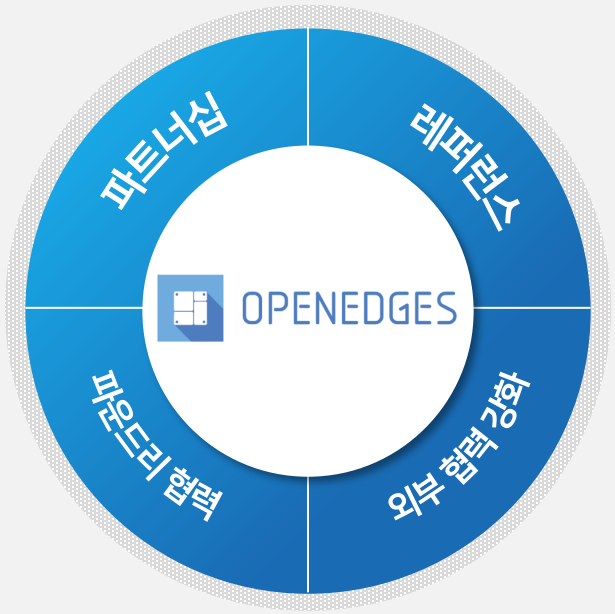
파운드리 협력관계 강화

tsmc

- 당사 PHY IP 라이선스 2개사가 설계 완료 후 TSMC에서 양산 진행 및 준비 중
- 양산 실적 확보 시 TSMC IP Alliance Program 정식 파트너로 편입될 예정(OIP*)

SAMSUNG

- 2018년 SAFE** IP 파트너 선정
- 메모리 인터페이스 분야 IP 협력 확대 중



Top tier 고객사 Reference 확보

SAMSUNG, SK hynix, Micron

글로벌 I 社

AISIN, alchip

VeriSilicon, MONTAGE Technology, JLQ TECHNOLOGY

RENESAS, MegaChips

외부 기업들과의 협력방안 모색

OPENEDGES

HYUNDAI → 계열사 → 42dot
460억 규모 정부 자율주행 과제 공동수행

bos SEMICONDUCTORS
IP 라이선스 계약

SK → 계열사 → SAPEON
IP 국책과제 수행

* 주1) OIP (Open Innovation Platform)
** 주2) SAFE (Samsung Advanced Foundry Ecosystem)

AI for Everyone, Everywhere

03

2025년 1Q 경영실적

01. 매출
02. 영업이익
03. 수주현황

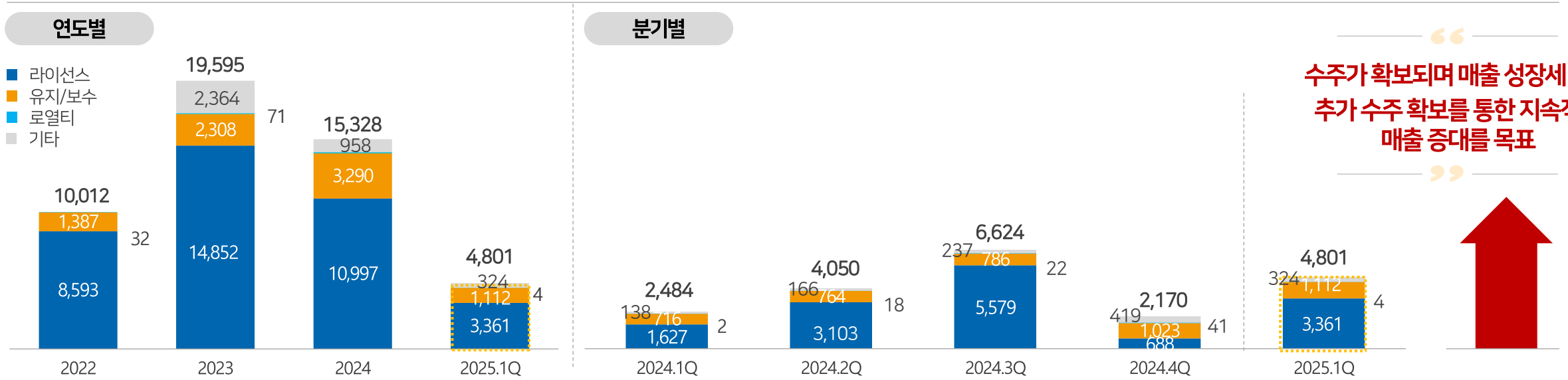
01 | 매출

'25년 1Q 매출은 48억으로 전분기 대비 121% (QoQ), 전년 동기 93%(YoY) 상승

수주 확보로 매출 성장세를 일부 회복

매출 현황

(단위: 백만원)



매출 변동요인

라이선스	연초 빠르게 수주가 확보되며 분기 매출 성장에 긍정적인 영향을 끼침, 지속적인 수주 확보로 인한 우상향 기대
유지보수	IP 라이선스 계약 증가에 따른 진행 Project 증가로 유지보수 매출은 지속적으로 확대 중
로열티	고객사의 칩 판매량 증가 시 로열티 매출은 장기적으로 우상향 할 것으로 보이나 칩 생산량에 따른 변동은 매 분기 발생할 것으로 보임
기타	오픈엣지스퀘어향 운영 및 기술 지원 서비스에 대한 매출로 분기당 2억 내외로 발생 중임

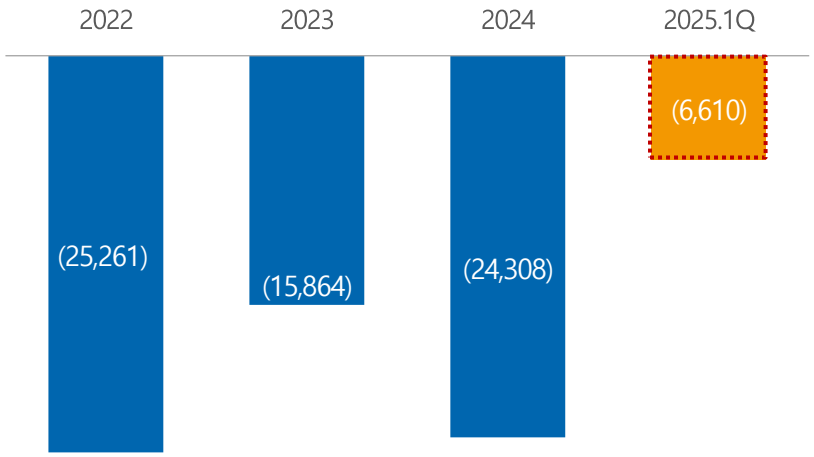
02 | 영업이익

인력 규모 확대에 따른 인건비 및 기타 경상연구개발비 증가로 분기당 비용규모 증가했으나 수주확보에 따른 매출 증가세도 함께 이루어지며 분기 수익성도 개선됨

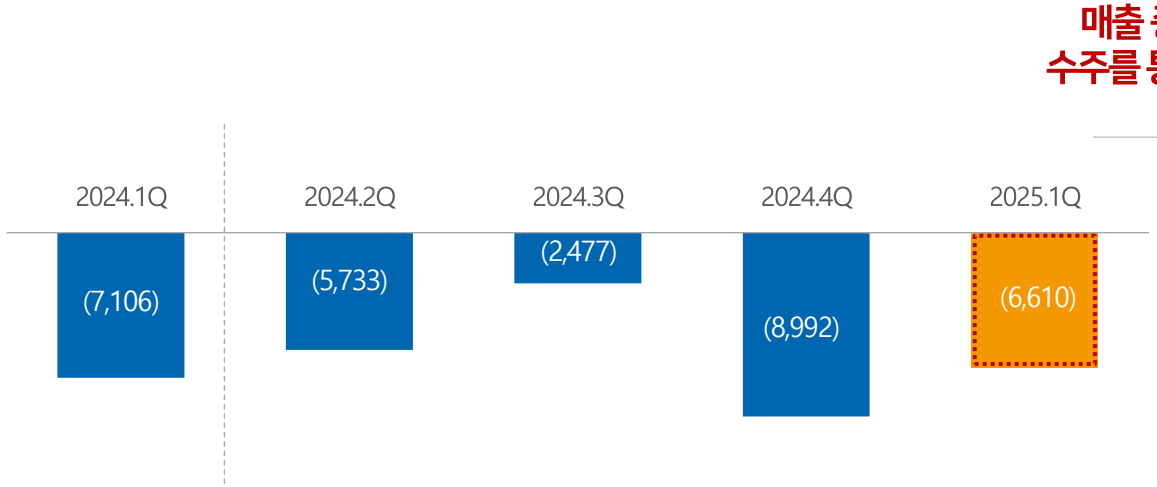
영업이익 현황

(단위: 백만원)

연도별



분기별



매출 증가하며 손실폭 감소
수주를 통해 수익성 개선을 기대

영업이익 변동요인

- 1Q부터 신규 수주 확보가 빠르게 진행되며 분기매출 반등 및 손실 규모 축소로 인한 수익성 개선
- 인력 규모 확대에 따른 인건비 증가와 신규 IP 개발로 인한 R&D 비용 증가로 총 비용 규모 증가했으나, 예상범위내에서 집행됨
- 지속적인 수주 확보를 통한 매출 증대와 함께 수익성 개선을 기대 중이며, 빠른 수주 확보를 위한 Sales 역량 강화에 총력

06 | 수주현황

'25년 1Q 총 수주 건수는 4건으로, 전분기 및 전년동기 대비 상승
ASP(건당 계약규모)도 $1.1M을 기록, 전분기 및 전년비 상승했으며 수익성 개선에 크게 기여

수주 현황

(단위: USD 1million)

□ '25.1Q : 총 라이선스 계약은 4건, ASP는 $1.1M 기록

- 빠르게 수주 확보에 성공하며, 매출반등 및 손실규모 축소에 성공
- 해외 고객사발 수주 및 TSMC향 IP 판매 호조로 인한 기대감 고조

□ '25년 전망 : 협의 중인 수주가 순차적으로 이루어질 것으로 예상

- 국내외 고객사들과 협의 중인 수주들이 순차적으로 이루어질 것으로 예상
- 단, 매크로 및 반도체 관련 대외 환경에 따른 영향은 예의주시 중

'25년 수주 실적

(단위:수/$M)	'25. 1Q (3개월)	'24. 4Q (3개월)	'24년 연간	'23년 연간	'22년 연간
건수	4	2	10	12	13
금액	$4.2M	$1.5M	$9.8M	$15.5M	$7.5M
(금액/건)	$1.1M	$0.7M	$1.0M	$1.3M	$0.6M

주요 실적 요인 및 향후 전망

'25 1Q 실적요인

□ 연초 신속히 수주 재개되며 매출 반등 및 수익성 개선

- '24년 미뤄졌던 PJT들이 빠르게 진행되며, 총 4개의 신규 PJT 확보 및 진행

□ 해외 고객사들의 신규 IP에 관한 문의 증가

- TSMC 6, 7, 12nm 등 신규IP 문의 발생, 특히 해외 고객사들의 문의 증가로 신규 PJT 확보

'25년 전망

□ Top-tier 고객사를 포함한 추가 PJT 수주로 인한 성장 재개 기대

- 첨단공정(TSMC6/7nm, SF 5nm 등) 용 고판가 중심 협의 진행 중

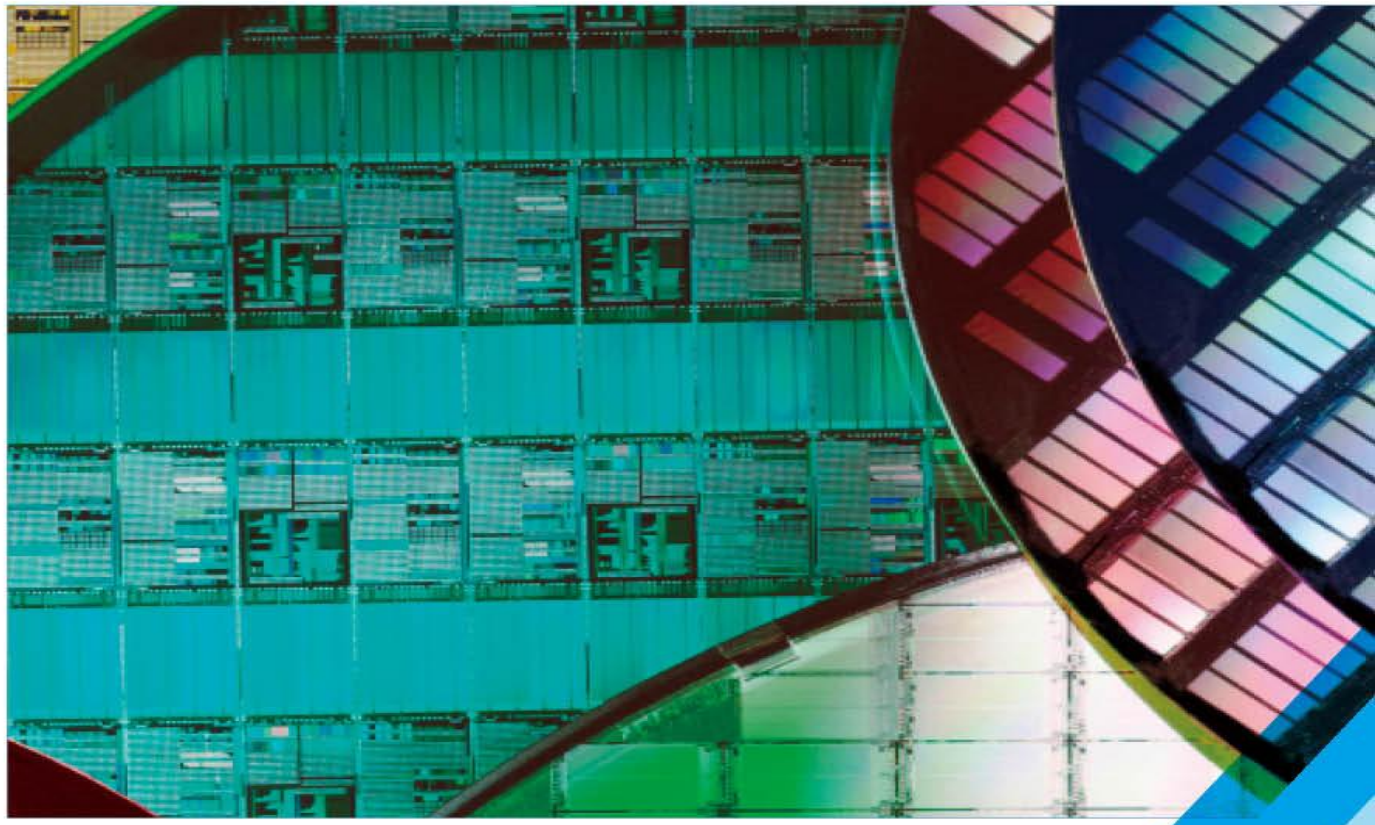
□ R&D의 지속적인 투자로 향후 성장동력 확보도 지속 추진할 예정

- 최신 메모리 표준인 LP6 관련 IP 및 선단공정(SF 4nm)용 IP 확보를 통한 기술경쟁력 확보
- UCIe, CCNoC 등 신규 IP 개발을 통한 신규 시장 확장도 성장성에 큰 도움이 될 것으로 예상

04

중장기 성장전략

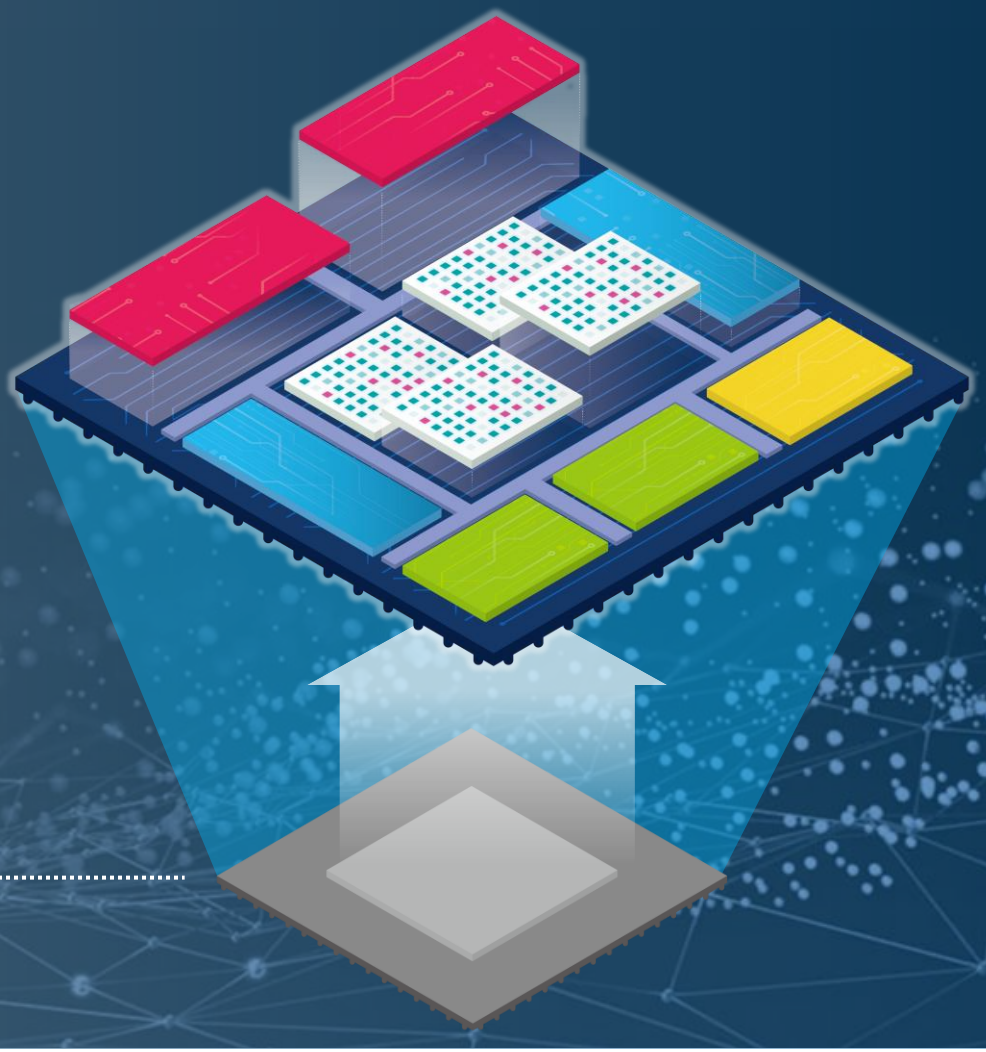
01. 중장기 성장 방향
02. 기존 IP 경쟁력 강화 방안
03. 상세 Portfolio 확대
04. 경쟁사 IP제품 Portfolio 현황



01 | 중장기 성장 방향

Multi Die/Chip

On-die



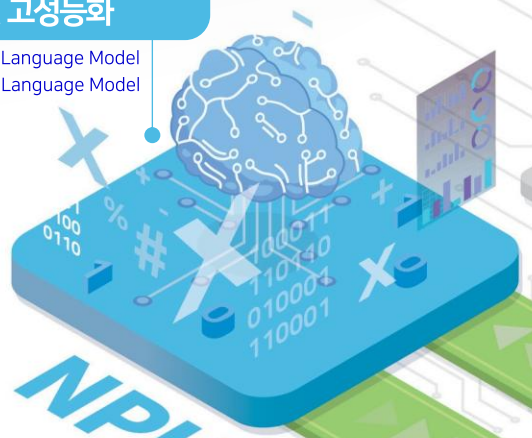
02 | 기존 IP 경쟁력 강화 방안

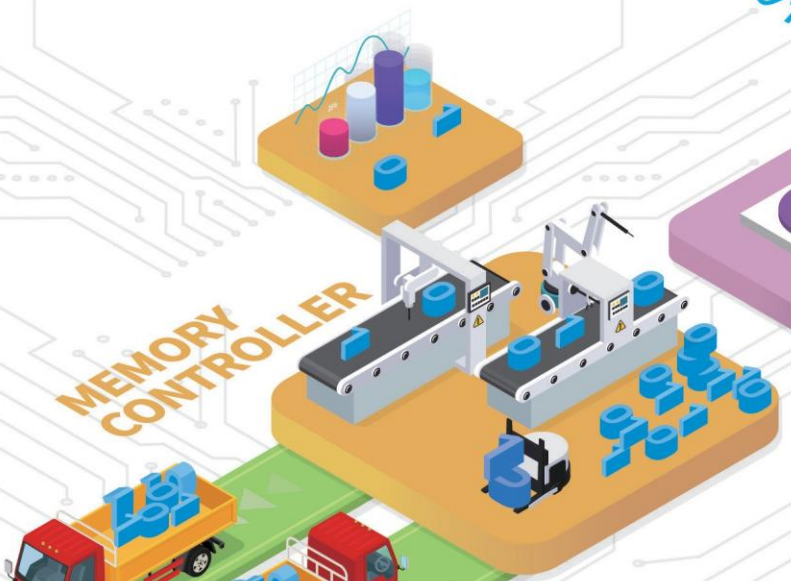
기존 IP 제품 고성능화 및 Coverage 확대 추진

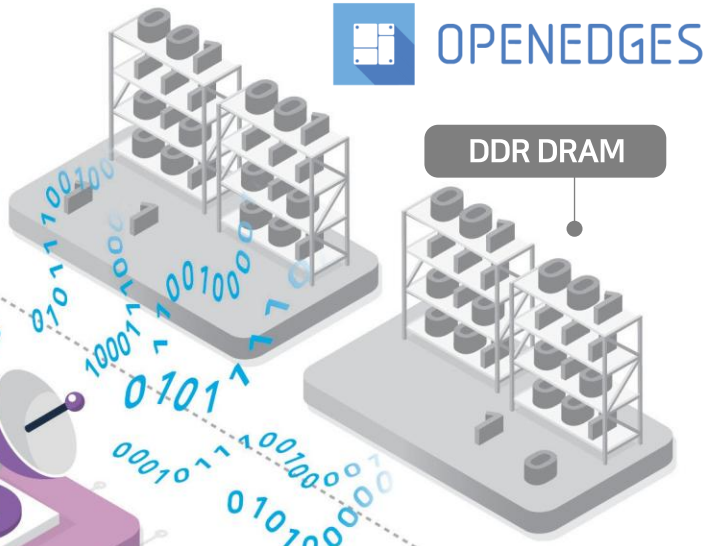
AI반도체

+ LLM 및 SLM 대응 및 고성능화

* LLM : Large Language Model
  SLM : Small Language Model







+ Porting House 운영 → 파운드리 공정 Coverage 확대

* PHY Porting House : 단순반복(Layout 등) 업무 담당, 베트남 or 동유럽 소재 자회사 설립 검토

+ Cache Coherence Network-on-Chip IP 개발 중

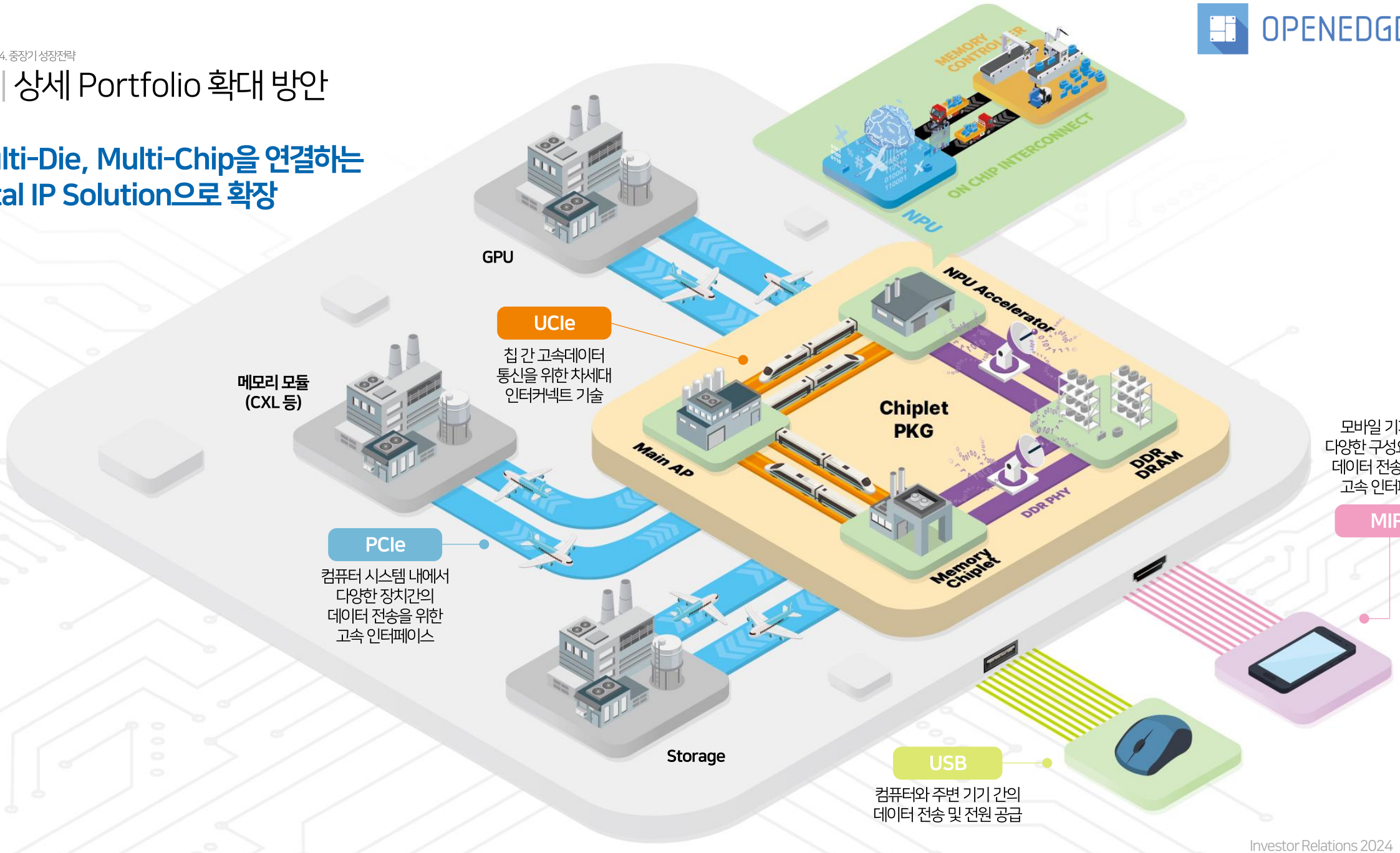
* SoC 내 Cache Memory의 Data 일관성을 유지하는 기능을 담당하는 IP로, 멀티코어 기반 고성능 AI 반도체 설계 시 요구되는 기술

+ IP 검증 자회사 운영 → IP Release Capa 확대 및 Cost Efficiency 제고

* 베트남 or 동유럽 소재 자회사 설립 검토

03 | 상세 Portfolio 확대 방안

Multi-Die, Multi-Chip을 연결하는 Total IP Solution으로 확장



04 | 경쟁사 IP제품 Portfolio 현황

2030년까지 Wired Interface IP 분야 핵심 IP별 개발 착수 후 2년내 상업화를 통해 제품 포트폴리오 완성도 제고

글로벌 Top 5 IP 기업 vs. 오픈엣지 제품 Portfolio 비교

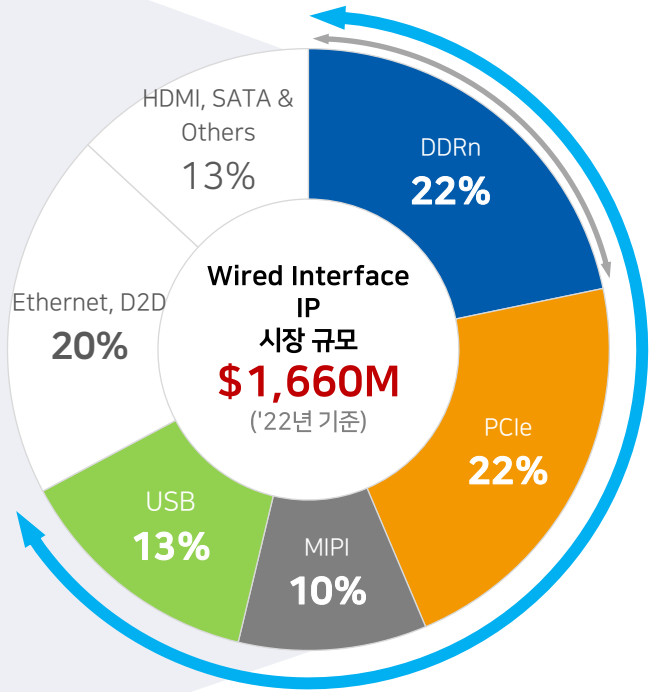
구 분			오픈엣지	arm	Synopsys	Cadence	Alphawave Semi	Imagination Technologies
Processor IP	CPU (Central Processing Unit)		-	●	● * RISC-V 기반	-	-	●
	GPU, ISP (Image Signal Processor)		-	●	-	-	-	●
	DSP (Digital Signal Processor)		-	-	●	●	-	-
	NPU (Neural Processing Unit)		●	○	○	○	-	●
Physical IP	Wired Interface IP	DDR Cont'r/PHY	●	-	●	●	-	-
		HBM Cont'r/PHY	●	-	●	●	●	-
		UCIe Cont'r/PHY	★	-	●	●	●	-
		PCIe Cont'r/PHY	★	-	●	●	●	-
		CXL Cont'r/PHY	★	-	●	●	●	-
		Ethernet	-	-	●	●	●	-
		USB	★	-	●	●	-	-
		SATA(Serial ATA)	-	-	●	●	-	-
		HDMI	-	-	●	●	-	-
		Display Port	-	-	●	●	-	-
		MIPI	★	-	●	●	-	-
	Memory Compilers (Others)		-	-	●	-	-	-
	Standard Cell & I/O		-	●	●	-	-	-
	Memory Compilers (SRAM)		-	●	●	-	-	-
	Analog & Mixed Signal		-	-	●	●	-	-
	Wireless Interface IP		-	-	●	-	-	-
Other Digital IP	Miscellaneous IP		-	-	●	●	-	-
	System IP (CC NoC, NCC NoC 등)		●	●	○	○	-	-
	Security IP		-	●	●	-	-	-

* ○: 당사가 시장에서 경쟁한 이력이 부족한 Non-Major 경쟁상대로 판단 (Low-end 중심)

★: 오픈엣지 추가 진출 후보군 ★: 2025년 / ★: 2026년 / ★: 2027년~

당사 참여 시장 Coverage 확대

22% → 67%



※ D2D(UCIe) 시장은 '22년 시장규모가 미미하여 Ethernet과 합쳐져 구분이 어려우나, 향후 칩렛 개발수요 증가로 고성장 예상

[Appendix] | 요약연결재무제표

요약 연결재무상태표

(단위: 백만원)

	1Q25	2024	2023	2021
유동자산	65,630	73,965	29,843	44,304
비유동자산	12,411	12,713	14,849	9,552
자산총계	**78,041**	**86,678**	**44,692**	**53,855**
유동부채	22,281	21,526	19,750	18,318
비유동부채	4,351	4,435	4,371	3,288
부채총계	**26,632**	**25,961**	**24,121**	**21,606**
자본금	2,484	2,482	2,146	2,116
자본잉여금	164,422	164,313	98,259	96,376
기타자본항목	1,582	4,633	3,577	2,026
이익잉여금	△117,078	△110,711	△83,412	△68,269
자본총계	**51,410**	**60,717**	**20,571**	**32,249**

※연결재무제표기준

요약 연결손익계산서

(단위: 백만원)

	1Q25	4Q24	증감	증감(%)
영업수익	**4,801**	**2,170**	**2,631**	**121.24**
영업비용	**11,411**	**11,466**	**-55**	**-0.48**
R&D 비용	8,828	8,446	382	4.52
기타영업비용	2,583	3,020	-437	-14.47
영업이익	**△6,610**	**△9,296**	**2,686**	**N/A**
기타수익	14	128	-114	-89.06
기타비용	2	0	2	325.09
금융수익	552	1,285	-733	-57.04
금융비용	321	3,314	-2,993	-90.31
세전이익	**△6,367**	**△11,197**	4,830	**N/A**
법인세비용	-	482	-482	N/A
당기순이익	**△6,367**	**△11,679**	**5,312**	**N/A**

※연결재무제표기준

[Appendix] | Financial Summary

Financial Summary

(단위: 백만원)

연결재무제표	2019	2020	2021	2022	2023					2024					1Q25
					1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	연간	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	연간	
매출	1,238	1,089	5,186	10,012	1,059	2,842	1,885	13,809	19,595	2,484	4,050	6,624	2,170	15,328	4,801
라이선스	990	660	4,342	8,593	555	2,370	1,261	10,666	14,852	1,627	3,103	5,579	688	10,997	3,361
유지보수	249	423	808	1,387	487	454	604	762	2,308	716	764	786	1,023	3,290	1,112
로열티	-	6	35	32	17	18	20	17	71	2	18	22	41	83	4
기타매출	-	-	-	-	-	-	-	2,363	2,363	138	166	237	419	958	324
비용	4,422	8,896	16,241	35,273	8,801	8,422	9,311	8,924	35,458	9,589	9,784	9,101	11,151	39,637	11,411
R&D 비용	2,347	6,623	10,654	27,710	7,052	6,546	7,146	6,439	27,184	7,543	7,816	7,095	8,135	30,590	8,828
기타영업비용	2,075	2,273	5,587	7,563	1,749	1,876	2,165	2,485	8,275	2,046	1,968	2,006	3,016	9,047	2,583
영업이익	△3,183	△7,807	△11,055	△25,261	△7,742	△5,581	△7,426	4,885	△15,864	△7,106	△5,733	△2,477	△8,981	△24,308	△6,610
법인세차감전이익	△8,487	△18,729	△14,524	△24,846	△7,634	△5,559	△7,317	6,000	△14,510	△7,106	△5,762	△2,757	△10,473	△26,108	△6,367
당기순이익	△8,487	△18,729	△14,608	△25,227	△7,631	△5,557	△7,310	5,642	△14,856	△7,106	△5,762	△2,739	△10,647	△26,265	△6,367

※연결재무제표 기준

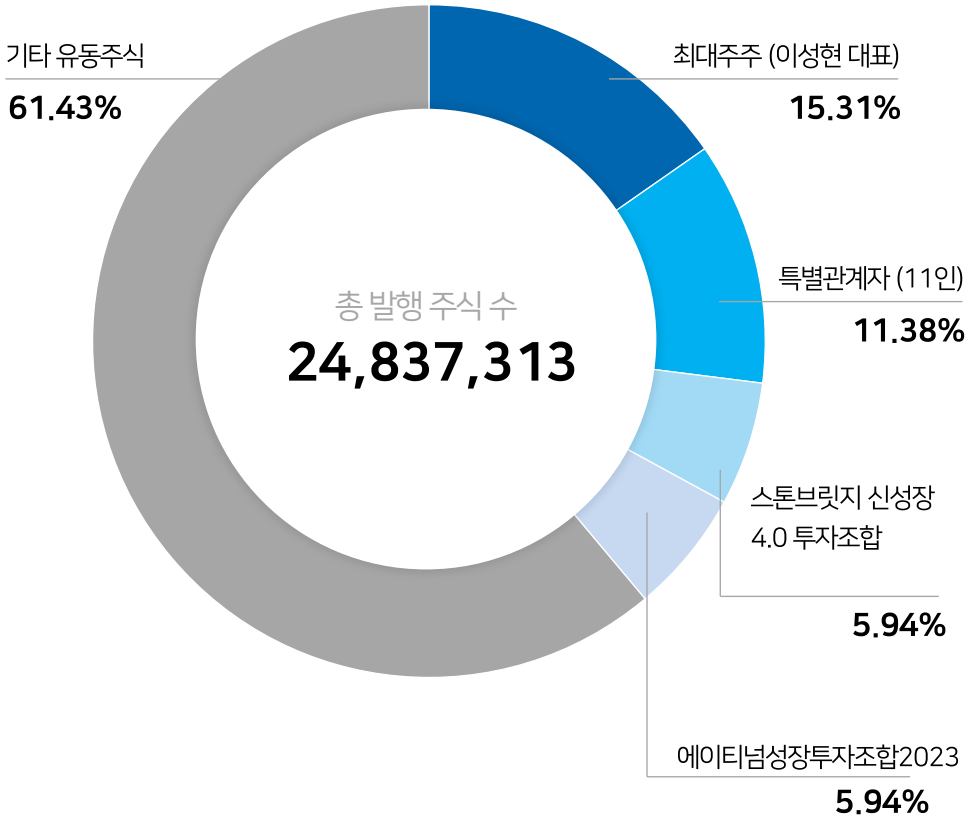
[Appendix] | 주주 현황

최대 주주 (이성현 대표) 지분율 15.31%, 특별 관계자 (11인) 합산 시 26.69%

* Co-founders, 임원 등

스톤브릿지와 에이티넘이 각각 5.94%씩 지분 보유 중

- **주주 현황 (기준일: '25.03.31.)**



Name	Type	# of shares	%
최대주주 (이성현 대표)	보통주	3,803,106	15.31%
특별관계자 (11인)	보통주	2,826,685	11.38%
스톤브릿지 신성장4.0투자조합	CPS	1,474,853	5.94%
에이티넘성장투자조합2023	CPS	1,474,853	5.94%
기타 유동주식	보통주	15,257,816	61.43%
Total		**24,837,313**	**100.00%**

※기준일: '25.03.31.

※참조: '24.7.22 제3자배정 유상증자를 통해 스톤브릿지와에이티넘이 각각 전환우선주 1,474,853주씩을 취득함